

钙钛矿薄膜太阳能电池的新一代生产设备开发工作，对设备的激光器、光学系统、加工幅面和生产效率等都进行了迭代升级，2023年公司已获得大客户GW级产线的部分订单以及部分新客户订单。

3. 公司涉及到先进封装的应用有哪些？是否出货？

答：公司从2021年开始布局集成电路先进封装应用，现有玻璃通孔（TGV）、激光开槽（low-k）、晶圆打标、模组钻孔（TMV）、激光解键合、辅助焊接等激光精细微加工设备，目前相关产品有少量出货，收入占比较低。

附件清单（如有）	无
日期	2023年12月22日